芯片行业市场深度分析及发展前景与投资价值研究报告(2026-2031版)

报告简介

过去50年，芯片行业遵循着“摩尔定律”，即在价格不变的情况下，集成在芯片上的晶体管数量每隔18到24个月将增加一倍，计算成本呈指数型下降。当前，摩尔定律仍然在支撑着5g和人工智能等新技术的发展，但随着工艺从微米级到纳米级，晶体管中原子数量越来越少，种种物理极限制约着摩尔定律的进一步发展。

大数据和人工智能等技术给芯片的生态系统带来了挑战，先进软件供应链更复杂了，为了满足消费者快速变化的需求，我们需要从系统出发，结合人工智能和大数据分析等技术，通过定制化的创芯来解决不同领域的系统复杂性。

进入“后摩尔时代”，由软件和大数据驱动的定制化芯片，更能为系统级公司建立差异化竞争优势。新思科技通过“智能编制”的设计方法学，从项目规划阶段就将特定软件和特定芯片需求结合，对芯片实现全生命周期管理和洞察，从而满足系统级公司对于芯片的不同需求。

在新技术新架构等推动下，芯片行业将向超级摩尔定律和超越摩尔定律两个方向继续向前发展。芯片产业如同钢铁、化工业等，已经成为数字社会的基础性百年产业，具有非常强大的生命力。

以能源行业为例，在构建以新能源加储能的新型电力体系过程中，数智化有着不可或缺的作用。新能源最大的问题是出力不稳定性，实现稳定、按需的输出，必须依靠大量的数据收集、处理、反馈和预测以及适量的储能配备。目前广泛推广的虚拟电厂及源网荷储都将对能源进行有效调节，而这都会涉及大量的运算。

中国芯片产业的市场规模将在未来10年内翻倍，成熟工艺将持续占据绝大部分市场。在发展成熟工艺方面，提高产能满足市场所需，是中国芯片未来的破局点。

本研究咨询报告由北京中道泰和信息咨询有限公司领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家商务部、国家发改委、国家经济信息中心、国务院发展研究中心、工信部、51行业报告网、全国及海外多种相关报纸杂志的基础信息等公布和提供的大量资料和数据，客观、多角度地对中国芯片行业市场进行了分析研究。报告在总结中国芯片行业发展历程的基础上，结合新时期的各方面因素，对中国芯片行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。报告资料详实，图表丰富，既有深入的分析，又有直观的比较，为芯片行业企业在激烈的市场竞争中洞察先机，能准确及时的针对自身环境调整经营策略。

报告目录

第一部分 产业环境透视

第一章 芯片产业发展综述 1

第一节 芯片基本情况 1

一、芯片定义 1

二、芯片分类与特点 1

三、芯片行业在国民经济中的地位 2

第二节 中国芯片行业业务模式 2

一、整合元件制造商模式(idm) 2

1、idm模式及其厂商 2

2、idm模式优劣势分析 3

二、垂直分工模式 3

1、ip核模式及其厂商 3

2、fabless模式及其厂商 4

3、foundry模式及其厂商 5

4、封装测试厂 5

第三节 芯片行业产业链分析 5

一、芯片产业链结构图 5

二、芯片产业链上游行业发展分析 6

1、芯片材料发展情况 6

(1)中国芯片材料制造业发展情况 6

(2)中国芯片材料业技术进展情况 9

2、芯片设备发展情况 10

(1)中国芯片设备制造发展情况 10

(2)中国芯片设备技术现状 11

(3)中国芯片设备产业布局 18

(4)国内外芯片设备产业的差距 18

(5)中国芯片设备产业存在的问题与对策 19

3、芯片国产化率环境现状 19

(1)国产替代机遇 20

(2)ai芯片发展现状 21

(3)国内厂商发展现状 21

三、芯片产业链下游行业发展分析 25

1、计算机 25

2、消费类电子 25

3、网络通信 25

4、汽车电子 26

四、芯片产业链环节国产工艺水平 28

1、cpu处理器类芯片 28

2、图像处理器gpu芯片 29

3、通信芯片 29

4、存储器芯片 30

5、消费电子芯片领域 30

6、时钟芯片 31

7、fpga芯片 31

8、晶圆制造领域 32

9、eda工具领域 32

10、芯片原材料领域 33

11、封装领域 34

12、测试领域 34

13、半导体设备领域 34

第二章 芯片行业市场环境及影响分析（pest） 36

第一节 芯片行业政策环境分析(p) 36

一、行业主要法律法规 36

1、《进一步鼓励软件和集成电路产业发展若干政策》 36

2、《中国制造》 43

3、《信息产业发展指南》 44

4、《国家集成电路产业发展推进纲要》 48

二、行业相关发展规划 49

1、《"十四五"国家信息化规划》 49

2、《"十四五"数字经济发展规划》 51

3、《"十四五"国家知识产权保护和运用规划》 52

4、《装备制造业标准化和质量提升规划》 53

三、各地芯片产业政策及重大项目 70

四、工信部批复集成电路封测创新中心 81

五、政策环境对行业的影响 81

第二节 行业经济环境分析(e) 82

一、宏观经济形势分析 82

二、宏观经济环境对行业的影响分析 83

第三节 行业社会环境分析(s) 84

一、芯片产业社会环境 84

二、社会环境对行业的影响 84

三、芯片产业发展对社会发展的影响 84

第四节 行业技术环境分析(t) 85

一、芯片技术分析 85

二、全球芯片技术的新进展 86

三、中西方芯片技术发展对比 87

1、中西方芯片技术发展差异 87

2、中西方芯片技术差异原因 88

第三章 国际芯片行业发展分析 92

第一节 国际芯片市场总体情况分析 92

一、国际芯片产业发展概况 92

二、国际芯片产业市场规模 93

三、国际芯片产业商业模式 94

四、国际芯片行业市场格局 95

第二节 国际主要国家(地区)市场分析 97

一、美国 97

1、美国芯片产业领先地位和竞争优势 97

2、美国芯片产业规模及其占全球市场份额 99

3、美国芯片历史发展经验对中国芯的启示 99

二、欧洲 99

1、欧洲芯片产业发展历史和地位 99

2、欧洲芯片产业规模及其占全球市场份额 101

3、欧洲主要国家芯片产业布局发展 101

4、欧洲芯片产业未来发展趋势 102

三、日本 103

1、日本芯片产业发展历史 103

2、日本芯片产业规模及其占全球市场份额 107

3、日本芯片发展经验对中国芯片产业的启示 107

四、韩国 108

1、韩国芯片产业发展概况 108

2、韩国芯片产业规模及技术研发水平 109

3、韩国政府全面支持ai芯片研发 109

五、中国台湾 110

1、台湾芯片产业发展概况 110

2、台湾芯片产业发展地位及趋势分析 111

六、俄罗斯 111

1、俄罗斯芯片发展概况 111

2、俄罗斯芯片产业概况 112

七、乌克兰 116

1、乌克兰芯片产业发展概况 116

第三节 国际重点芯片企业运营分析 116

一、高通 116

二、英特尔 117

三、三星 117

第四节 中美贸易摩擦：以色列或是中国芯片行业突破口 118

一、中美贸易摩擦及美国对中国芯片行业的打击 118

二、以色列半导体行业概况 118

三、各大国际芯片巨头纷纷逐鹿以色列 119

四、以色列芯片研发行业的优势 120

五、以色列或是中国芯片行业的突破口 121

第四章 中国芯片行业运行现状分析 123

第一节 中国芯片行业发展状况分析 123

一、中国芯片行业发展阶段 123

二、中国芯片行业发展概况 123

三、中国芯片行业发展现状 126

四、中国芯片产业将获多重支持 127

1、紫光集团升级 127

2、大基金革新 128

3、资本市场力挺 133

4、需要顶层设计 133

第二节 中国芯片设计业 134

一、芯片设计业发展概况 134

二、芯片设计业市场规模 137

三、芯片设计业产业特征 137

四、芯片设计业竞争格局 139

五、芯片设计业发展趋势 141

六、芯片设计业发展思路和政策建议 141

第三节 中国芯片制造业 143

一、芯片制造业发展概况 143

二、芯片制造业市场规模 144

三、芯片制造业产业特征 144

四、芯片制造业竞争格局 145

五、芯片制造业发展趋势 146

六、芯片制造业发展前景 146

第四节 中国芯片封测业 147

一、芯片封测业发展概况 147

二、芯片封测业市场规模 149

三、芯片封测业产业特征 149

四、芯片封测业竞争格局 153

五、芯片封测业发展趋势 153

1、行业发展趋势 153

2、封装技术发展呈现两大趋势 154

(1)微型化 154

(2)集成化 155

六、芯片封测业发展前景 155

第五章 中国芯片行业整体运行指标分析 157

第一节 中国芯片行业总体规模分析 157

一、企业数量结构分析 157

二、人员规模状况分析 157

三、行业资产规模分析 158

四、行业市场规模分析 159

第二节 中国芯片行业财务指标总体分析 159

一、行业盈利能力分析 159

二、行业偿债能力分析 159

三、行业营运能力分析 160

四、行业发展能力分析 161

五、行业研发投入分析 161

第三节 2021-2026年中国芯片市场供需情况分析 162

一、中国芯片行业供给情况 162

1、中国芯片行业供给分析 162

2、中国芯片行业产品产量分析 162

3、重点企业产能及占有份额 163

二、中国芯片行业需求情况 163

1、中国芯片行业需求分析 163

2、中国芯片行业客户结构 164

3、中国芯片行业需求的地区差异 164

三、中国芯片行业供需平衡分析 165

四、2026-2031中中国芯片市场供需预测 165

第四节 中国芯片市场价格走势分析 167

一、芯片市场价格影响因素 167

二、芯片市场产品价格走势 167

第五节 中国芯片行业进出口市场分析 168

一、中国芯片行业进出口综述 168

二、中国芯片行业出口市场分析 168

三、中国芯片行业进口市场分析 168

第六节 中国芯片资本市场发展情况 169

一、ipo情况 169

二、芯片行业融资时间汇总 170

三、2021-2026年重点的融资项目 175

第六章 中国芯片细分产品市场发展分析 177

第一节 nb-iot芯片 177

一、市场整体发展现状 177

二、国内nb-iot芯片发展水平分析 177

三、行业市场规模及需求情况 179

四、行业竞争现状 183

1、市场竞争格局 183

2、市场主要供应商 183

3、国内主要供应商 184

五、行业发展前景 185

第二节 mcu芯片 185

一、市场整体发展现状 185

二、国内mcu芯片发展水平分析 186

三、行业市场规模及需求情况 186

四、行业竞争现状 186

1、市场竞争格局 186

2、市场主要供应商 186

3、国内主要供应商 189

五、行业发展前景 190

第三节 dsp芯片 191

一、市场整体发展现状 191

二、国内dsp芯片发展水平分析 191

三、行业市场规模及需求情况 192

四、行业竞争现状 192

1、市场竞争格局 192

2、市场主要供应商 193

3、国内主要供应商 194

五、行业发展前景 195

第四节 fpga芯片 196

一、市场整体发展现状 196

二、国内fpga芯片发展水平分析 197

三、行业市场规模及需求情况 198

四、行业竞争现状 198

1、市场竞争格局 198

2、市场主要供应商 198

3、国内主要供应商 199

五、行业发展前景 200

第五节 存储芯片 201

一、市场整体发展现状 201

二、国内存储芯片发展水平分析 202

三、行业市场规模及需求情况 202

四、行业竞争现状 203

1、市场竞争格局 203

2、市场主要供应商 203

3、国内主要供应商 203

五、行业发展前景 204

六、3d nand flash将会是中国存储芯片的一个突破口 205

第六节 人工智能(ai)芯片 206

一、人工智能芯片产业拉开发展帷幕 206

1、人工智能引爆芯片市场新需求 206

2、全球人工智能芯片领域高速发展 208

3、中国人工智能芯片领域创新活跃 209

二、gpu、fpga、asic、tpu 四大 ai 芯片分析 210

1、gpu 210

(1)gpu及其特点 210

(2)gpu技术主要优劣势 210

2、fpga 211

(1)fpga及其特点 211

(2)fpga技术主要优劣势 211

3、asic 212

(1)asic及其特点 212

(2)asic芯片主要优劣势 212

4、tpu 213

(1)tpu及其特点 213

(2)tpu技术主要优劣势 213

三、行业市场规模及需求情况 213

四、行业竞争现状 214

1、市场竞争格局 214

2、市场主要供应商 215

3、国内主要供应商 216

五、市场最新动态 217

六、行业发展前景 218

第七节 4g和5g芯片 218

一、市场整体发展规模 218

二、国内4g和5g芯片发展水平分析 219

三、4g和5g芯片需求水平 219

第七章 中国芯片应用市场需求分析 221

第一节 中国芯片市场需求分析 221

一、sim芯片市场 221

1、sim芯片市场需求现状 221

2、sim芯片市场需求规模 222

3、sim芯片市场竞争格局 222

4、sim芯片市场需求前景 222

二、移动支付芯片市场 223

1、移动支付芯片市场需求现状 223

2、移动支付芯片市场需求规模 225

3、移动支付芯片市场竞争格局 226

4、移动支付芯片市场需求前景 226

三、身份识别类芯片市场 227

1、身份识别芯片市场需求现状 227

2、身份识别芯片市场需求规模 228

3、身份识别芯片市场竞争格局 228

4、身份识别芯片市场需求前景 228

四、金融支付类芯片市场 229

1、金融支付类芯片市场需求现状 229

2、金融支付类芯片市场需求规模 229

3、金融支付类芯片市场竞争格局 230

4、金融支付类芯片市场需求前景 230

五、usb-key芯片市场 230

1、usb-key芯片市场需求现状 230

2、usb-key芯片市场需求规模 231

3、usb-key芯片市场竞争格局 231

4、usb-key芯片市场需求前景 231

六、通讯射频芯片市场 232

1、通讯射频芯片市场需求现状 232

2、通讯射频芯片市场需求规模 232

3、通讯射频芯片市场竞争格局 232

4、通讯射频芯片市场需求前景 233

七、通讯基带芯片市场 234

1、通讯基带芯片市场需求现状 234

2、通讯基带芯片市场需求规模 234

3、通讯基带芯片市场竞争格局 234

4、通讯基带芯片市场需求前景 237

八、家电控制芯片市场 237

1、家电控制芯片市场需求现状 237

2、家电控制芯片市场需求规模 237

3、家电控制芯片市场竞争格局 238

4、家电控制芯片市场需求前景 238

九、家电应用类芯片市场 238

1、家电应用类芯片市场需求现状 238

2、家电应用类芯片市场需求规模 239

3、家电应用类芯片市场竞争格局 240

4、家电应用类芯片市场需求前景 240

十、电脑数码类芯片市场 241

1、电脑数码类芯片市场需求现状 241

2、电脑数码类芯片市场需求规模 241

3、电脑数码类芯片市场竞争格局 241

4、电脑数码类芯片市场需求前景 242

第二节 中国芯片下游市场需求分析 242

一、计算机行业 242

1、计算机行业发展现状 242

2、计算机行业对芯片需求分析 244

二、智能手机行业 244

1、智能手机行业发展现状 244

2、智能手机行业对芯片需求分析 245

三、可穿戴设备行业 245

1、可穿戴设备行业发展现状 245

2、可穿戴设备行业对芯片需求分析 246

四、工业控制行业 247

1、工业控制行业发展现状 247

2、工业控制行业对芯片需求分析 248

五、汽车电子行业 248

1、汽车电子行业发展现状 248

2、汽车电子行业对芯片需求分析 250

第八章 中国芯片行业区域市场分析 251

第一节 长三角地区 251

一、上海 251

1、芯片产业发展概况 251

2、芯片产业政策规划 253

3、芯片设计业发展分析 255

4、芯片制造业发展分析 255

5、芯片封测业发展分析 256

6、芯片产业发展前景分析 256

二、江苏 257

1、芯片产业发展概况 257

2、芯片产业政策规划 258

3、芯片设计业发展分析 259

4、芯片制造业发展分析 259

5、芯片封测业发展分析 259

6、芯片产业发展前景分析 259

三、浙江 260

1、芯片产业发展概况 260

2、芯片产业政策规划 261

3、芯片设计业发展分析 263

4、芯片制造业发展分析 263

5、芯片封测业发展分析 264

6、芯片产业发展前景分析 264

第二节 环渤海地区 264

一、北京 264

1、芯片产业发展概况 264

2、芯片产业政策规划 266

3、芯片设计业发展分析 267

4、芯片制造业发展分析 267

5、芯片封测业发展分析 268

6、芯片产业发展前景分析 268

二、天津 269

1、芯片产业发展概况 269

2、芯片产业政策规划 269

3、芯片设计业发展分析 270

4、芯片制造业发展分析 270

5、芯片封测业发展分析 271

6、芯片产业发展前景分析 271

三、大连 273

1、芯片产业发展概况 273

2、芯片产业政策规划 273

3、芯片设计业发展分析 274

4、芯片制造业发展分析 274

5、芯片封测业发展分析 275

6、芯片产业发展前景分析 275

第三节 中西部地区 275

一、重庆 275

1、芯片产业发展概况 275

2、芯片产业政策规划 276

3、芯片设计业发展分析 277

4、芯片制造业发展分析 277

5、芯片封测业发展分析 277

6、芯片产业发展前景分析 278

二、成都 280

1、芯片产业发展概况 280

2、芯片产业政策规划 281

3、芯片设计业发展分析 286

4、芯片制造业发展分析 286

5、芯片封测业发展分析 286

6、芯片产业发展前景分析 287

三、西安 287

1、芯片产业发展概况 287

2、芯片产业政策规划 289

3、芯片设计业发展分析 291

4、芯片制造业发展分析 291

5、芯片封测业发展分析 292

6、芯片产业发展前景分析 293

四、武汉 294

1、芯片产业发展概况 294

2、芯片产业政策规划 295

3、芯片设计业发展分析 297

4、芯片制造业发展分析 298

5、芯片封测业发展分析 298

6、芯片产业发展前景分析 298

五、长沙 298

1、芯片产业发展概况 298

2、芯片产业政策规划 299

3、芯片设计业发展分析 299

4、芯片制造业发展分析 300

5、芯片封测业发展分析 300

6、芯片产业发展前景分析 301

第四节 珠三角及其它地区 302

一、深圳 302

1、芯片产业发展概况 302

2、芯片产业政策规划 302

3、芯片设计业发展分析 305

4、芯片制造业发展分析 305

5、芯片封测业发展分析 306

6、芯片产业发展前景分析 306

二、厦门 306

1、芯片产业发展概况 306

2、芯片产业政策规划 307

3、芯片设计业发展分析 309

4、芯片制造业发展分析 310

5、芯片封测业发展分析 311

6、芯片产业发展前景分析 311

三、泉州 312

1、芯片产业发展概况 312

2、芯片产业政策规划 312

3、芯片设计业发展分析 314

4、芯片制造业发展分析 314

5、芯片封测业发展分析 315

6、芯片产业发展前景分析 315

四、安徽 316

1、芯片产业发展概况 316

2、芯片产业政策规划 317

3、芯片设计业发展分析 317

4、芯片制造业发展分析 318

5、芯片封测业发展分析 318

6、芯片产业发展前景分析 318

第九章 2026-2031中芯片行业竞争形势分析 320

第一节 芯片行业总体市场竞争状况分析 320

一、芯片行业竞争结构分析 320

1、现有企业间竞争 320

2、潜在进入者分析 321

3、替代品威胁分析 321

4、供应商议价能力 322

5、客户议价能力 322

二、芯片行业集中度分析 323

三、芯片行业swot分析 325

第二节 芯片行业竞争格局分析 327

一、产品竞争格局 327

二、企业竞争格局 327

三、品牌竞争格局 327

第三节 中国芯片行业竞争力分析 328

一、中国芯片行业竞争力剖析 328

二、中国芯片行业核心竞争力剖析 328

三、提升中国芯片产业核心竞争力 328

1、提高扶持资金集中运用率 328

2、制定融资投资制度 330

3、提高政府采购力度 330

4、建立技术中介服务制度 331

5、人才引进与人才培养 331

四、中国芯片企业市场竞争的优势 332

五、国内芯片企业竞争能力提升途径 333

第四节 中国芯片产业国际竞争力现状及提升策略 333

一、中国芯片产业国际竞争力分析 333

二、中国芯片产业国际竞争力影响因素分析 333

1、生产要素 333

2、需求要素 334

3、市场结构和竞争态势 334

4、政府政策 334

三、中国提升芯片产业国际竞争力策略分析 335

第十章 中国芯片行业领先企业经营形势分析 336

第一节 中国十大芯片设计企业发展分析 336

一、深圳市海思半导体有限公司 336

1、企业发展概况 336

2、企业主营业务 336

3、企业经营情况 336

4、企业产业布局 337

5、企业最新动态 337

6、企业战略策划 338

二、紫光集团有限公司 339

1、企业发展概况 339

2、企业主营业务 339

3、企业经营情况 339

4、企业产业布局 340

5、企业最新动态 346

6、企业战略策划 347

三、深圳市中兴微电子技术有限公司 347

1、企业发展概况 347

2、企业主营业务 347

3、企业经营情况 348

4、企业产业布局 348

5、企业最新动态 348

6、企业战略策划 349

四、华大半导体有限公司 349

1、企业发展概况 349

2、企业主营业务 349

3、企业经营情况 349

4、企业产业布局 350

5、企业最新动态 350

6、企业战略策划 351

五、北京智芯微电子科技有限公司 351

1、企业发展概况 351

2、企业主营业务 351

3、企业经营情况 351

4、企业产业布局 352

5、企业最新动态 352

6、企业战略策划 353

六、深圳市汇顶科技股份有限公司 353

1、企业发展概况 353

2、企业主营业务 353

3、企业经营情况 353

4、企业产业布局 354

5、企业最新动态 355

6、企业战略策划 355

七、杭州士兰微电子股份有限公司 355

1、企业发展概况 355

2、企业主营业务 356

3、企业经营情况 356

4、企业产业布局 356

5、企业最新动态 357

6、企业战略策划 357

八、大唐半导体设计有限公司 357

1、企业发展概况 357

2、企业主营业务 358

3、企业经营情况 358

4、企业产业布局 358

5、企业最新动态 358

6、企业战略策划 359

九、敦泰科技(深圳)有限公司 360

1、企业发展概况 360

2、企业主营业务 360

3、企业经营情况 360

4、企业产业布局 361

5、企业最新动态 361

6、企业战略策划 361

十、北京中星微电子有限公司 361

1、企业发展概况 361

2、企业主营业务 362

3、企业经营情况 362

4、企业产业布局 362

5、企业最新动态 362

6、企业战略策划 363

十一、兆易创新科技集团股份有限公司 363

1、企业发展概况 363

2、企业主营业务 363

3、企业经营情况 364

4、企业产业布局 364

5、企业最新动态 366

6、企业战略策划 367

十二、北京奕斯伟科技集团有限公司 370

1、企业发展概况 370

2、企业主营业务 370

3、企业经营情况 370

4、企业产业布局 371

5、企业最新动态 371

6、企业战略策划 371

第二节 中国十大芯片制造企业发展分析 372

一、三星(中国)半导体有限公司 372

1、企业发展概况 372

2、企业主营业务 372

3、企业经营情况 374

4、企业产业布局 374

5、企业最新动态 374

6、企业战略策划 375

二、中芯国际集成电路制造有限公司 375

1、企业发展概况 375

2、企业主营业务 376

3、企业经营情况 376

4、企业产业布局 377

5、企业最新动态 377

6、企业战略策划 378

三、sk海力士半导体(中国)有限公司 378

1、企业发展概况 378

2、企业主营业务 379

3、企业经营情况 379

4、企业产业布局 380

5、企业最新动态 380

6、企业战略策划 381

四、英特尔半导体(大连)有限公司 381

1、企业发展概况 381

2、企业主营业务 381

3、企业经营情况 382

4、企业产业布局 382

5、企业最新动态 382

6、企业战略策划 383

五、上海华虹宏力半导体制造有限公司 383

1、企业发展概况 383

2、企业主营业务 383

3、企业经营情况 383

4、企业产业布局 384

5、企业最新动态 384

6、企业战略策划 384

六、无锡华润微电子有限公司 384

1、企业发展概况 384

2、企业主营业务 385

3、企业经营情况 385

4、企业产业布局 385

5、企业最新动态 386

6、企业战略策划 387

七、台积电(中国)有限公司 387

1、企业发展概况 387

2、企业主营业务 387

3、企业经营情况 388

4、企业产业布局 389

5、企业最新动态 389

6、企业战略策划 389

八、西安微电子技术研究所 389

1、企业发展概况 389

2、企业主营业务 390

3、企业经营情况 390

4、企业产业布局 390

5、企业最新动态 391

6、企业战略策划 391

九、武汉新芯集成电路制造有限公司 391

1、企业发展概况 391

2、企业主营业务 391

3、企业经营情况 392

4、企业产业布局 392

5、企业最新动态 392

6、企业战略策划 393

十、和舰芯片制造(苏州)股份有限公司 393

1、企业发展概况 393

2、企业主营业务 394

3、企业经营情况 394

4、企业产业布局 394

5、企业最新动态 395

6、企业战略策划 396

第三节 中国十大半导体封装测试企业发展分析 396

一、江苏新潮科技集团有限公司 396

1、企业发展概况 396

2、企业主营业务 396

3、企业经营情况 396

4、企业产业布局 397

5、企业最新动态 398

6、企业战略策划 399

二、南通华达微电子集团有限公司 399

1、企业发展概况 399

2、企业主营业务 399

3、企业经营情况 399

4、企业产业布局 400

5、企业最新动态 400

6、企业战略策划 400

三、威讯联合半导体(北京)有限公司 401

1、企业发展概况 401

2、企业主营业务 401

3、企业经营情况 401

4、企业产业布局 401

5、企业最新动态 401

6、企业战略策划 402

四、天水华天电子集团股份有限公司 402

1、企业发展概况 402

2、企业主营业务 404

3、企业经营情况 404

4、企业产业布局 405

5、企业最新动态 405

6、企业战略策划 405

五、安世半导体(中国)有限公司 406

1、企业发展概况 406

2、企业主营业务 406

3、企业经营情况 406

4、企业产业布局 407

5、企业最新动态 408

6、企业战略策划 409

六、英特尔产品(成都)有限公司 409

1、企业发展概况 409

2、企业主营业务 409

3、企业经营情况 410

4、企业产业布局 410

5、企业最新动态 410

6、企业战略策划 411

七、海太半导体(无锡)有限公司 411

1、企业发展概况 411

2、企业主营业务 411

3、企业经营情况 412

4、企业产业布局 413

5、企业最新动态 413

6、企业战略策划 413

八、上海凯虹科技电子有限公司 414

1、企业发展概况 414

2、企业主营业务 414

3、企业经营情况 414

4、企业产业布局 415

5、企业最新动态 415

6、企业战略策划 415

九、安靠封装测试(上海)有限公司 415

1、企业发展概况 415

2、企业主营业务 416

3、企业经营情况 416

4、企业产业布局 417

5、企业最新动态 417

6、企业战略策划 417

十、晟碟半导体(上海)有限公司 417

1、企业发展概况 417

2、企业主营业务 417

3、企业经营情况 418

4、企业产业布局 418

5、企业最新动态 418

6、企业战略策划 419

十一、江苏长电科技股份有限公司 419

1、企业发展概况 419

2、企业主营业务 420

3、企业经营情况 420

4、企业产业布局 421

5、企业最新动态 422

6、企业战略策划 423

十二、通富微电子股份有限公司 425

1、企业发展概况 425

2、企业主营业务 425

3、企业经营情况 426

4、企业产业布局 426

5、企业最新动态 427

6、企业战略策划 427

第十一章 芯片行业发展前景及投资价值 429

第一节 物联网连接芯片发展研究 429

一、物联网连接芯片的定义与分类 429

二、物联网连接芯片应用市场分析 432

1、物联网市场发展情况 432

2、物联网连接芯片市场特点 433

3、物联网典型应用场景分析 435

三、物联网连接芯片典型产品发展情况分析 438

1、蓝牙芯片 438

2、wi-fi芯片 439

3、nfc芯片 441

第二节 新冠肺炎疫情对芯片行业的影响 442

一、对全球及中国芯片市场供需的影响 442

二、对芯片产业链的影响及对策 443

第三节 2026-2031中芯片市场发展前景与趋势 445

一、2026-2031中芯片市场规模预测 445

二、2026-2031中芯片市场发展前景展望 446

三、2026-2031中芯片细分行业发展前景分析 446

四、2026-2031中芯片行业发展趋势 447

1、新兴领域需求提升，持续开拓市场空间 447

2、芯片行业将向发展中国家进行迁移 447

3、资本运作加速是未来芯片行业的主要趋势之一 448

4、芯片设计在产业链占比持续提升 448

五、2026-2031中细分市场发展趋势预测 448

第十二章 芯片行业投资机会与风险防范 449

第一节 芯片行业投资特性分析 449

一、芯片行业进入壁垒分析 449

1、技术壁垒 449

2、人才壁垒 449

3、资金壁垒 449

4、客户壁垒 450

5、专利壁垒 450

二、芯片行业盈利因素分析 453

三、芯片行业盈利模式分析 453

第二节 中国芯片行业投融资运行状况 454

一、国家集成电路产业投资基金 454

1、大基金基本情况 454

2、大基金的重要意义 455

3、大基金一期投资情况 456

(1)投资企业梳理 456

(2)投资方式分析 458

(3)投资领域分析 460

(4)一期成果汇总 461

4、大基金二期投资动态 461

5、大基金取得的成效 461

6、大基金下一步的工作思路 463

二、芯片产业基金地方动态分析 463

三、推进中国芯片产业发展的投融资建议 464

1、鼓励发展集成电路产业风险和私募投资资本 464

2、积极参与海外收购，集中建立产业园 465

3、加强与国际资本合作，推动中国企业走出去 465

4、建设集成电路投融资平台，促进资本和产业的交流 466

第三节 2026-2031中芯片行业投资机会 466

一、芯片产业投资机会 466

二、中国芯片产业发展机遇 466

1、全球半导体销售和投资进入新一轮高增长 466

2、国家政策引导，成立大基金重点扶植ic产业 467

3、地方层面也把芯片当成战略支柱性产业来发展 467

4、中国集成电路产业发展目标和主要任务 467

5、半导体产业新热点和未来核心产品 467

第四节 2026-2031中芯片行业投资风险及防范 468

一、风险分析 468

1、国家政策变动风险 468

2、产业转移不及预期 468

3、技术更新换代风险 468

二、风险防范 469

第五节 中国芯片行业投资建议 469

一、芯片行业投资方向 469

二、芯片行业投资建议 469

第十三章 中国芯片行业面临的困境及对策 471

第一节 中国芯片行业面临的困境及挑战 471

一、中国芯片行业发展面临的困境与对策 471

二、中国芯片企业发展面临的困境与对策 473

三、中国芯片市场发展面临的挑战与对策 475

第二节 全球价值链视角下中国芯片产业升级路径研究 477

一、全球价值链理论 477

二、全球芯片产业价值链构成 478

1、"微笑曲线" 478

2、全球芯片产业价值链发展概况 479

3、中国在全球芯片产业价值链中的定位 479

三、中国芯片产业发展中存在的问题 482

四、中国芯片产业升级策略 483

第三节 探索中国集成电路创新发展之路 483

一、海外芯片创新模式 483

二、国家集成电路创新中心 488

三、长三角一体化国家战略下芯片的协同发展 489

第十四章 芯片行业发展战略研究 491

第一节 芯片行业发展战略研究 491

一、芯片产业国家战略 491

二、国际龙头芯片企业战略研究 491

三、国内重点芯片企业战略部署 492

四、"十三五"时期芯片企业成功战略实施 492

五、"十四五"时期芯片产业规划展望 493

六、ai芯片发展迅猛，核心专用芯片将成战略制高点 493

七、芯片行业竞争战略思考 494

第二节 对中国芯片品牌的战略思考 495

一、芯片实施品牌战略的意义 495

二、芯片企业品牌的现状分析 495

三、中国芯片企业的品牌战略 497

四、芯片品牌战略管理的策略 499

第三节 芯片经营策略分析 502

一、芯片市场细分策略 502

二、芯片市场创新策略 504

三、品牌定位与品类规划 506

四、芯片新产品差异化战略 518

图表目录

图表：芯片产业链结构图 5

图表：产业链概况及关键设备介绍 18

图表：芯片产业链国产化率(%) 20

图表：2021-2026年华虹设备招标采购(台) 22

图表：2021-2026年华虹设备招标采购国产化占比(台) 22

图表：2021-2026年长江存储设备招标采购(台) 23

图表：2021-2026年长江存储设备招标采购国产化占比(台) 23

图表：2021-2026年中芯绍兴设备招标采购(台) 24

图表：2021-2026年中芯绍兴设备招标采购国产化占比(台) 24

图表：2021-2026年汽车电子成本占比将达整车35% 27

图表：2021-2026年全球半导体市场规模(亿美金) 93

图表：全球芯片产业商业模式 94

图表：fabless模式下芯片产业各类型的特征 95

图表：半导体产业相关公司 140

图表：国内十大集成电路(芯片)设计企业 140

图表：国内十大集成电路制造企业 145

图表：国内十大集成电路封测企业 153

图表：封装技术微型化发展 155

图表：2021-2026年集成电路行业从业人员占比情况(单位：%) 158

图表：2021-2026年芯片产业资产规模情况(单位：亿元) 158

图表：2021-2026年芯片行业销售利润率(单位：%) 159

图表：2021-2026年芯片行业资产负债率(单位：%) 160

图表：2021-2026年芯片行业应收账款周转率(单位：次) 160

图表：2021-2026年芯片行业利润总额增长率(单位：%) 161

图表：中国集成电路研发投入情况(亿元) 162

图表：中国芯片应用结构(单位：%) 164

图表：2021-2026年集成电路行业融资事件 170

图表：2021-2026年集成电路融资情况 174

图表：物联网通信技术介绍 183

图表：nb-iot垂直应用领域 184

图表：我国mcu行业代表企业 190

图表：全国主要fpga企业市场份额分布(单位：%) 199

图表：人工智能芯片分类 209

图表：全定制芯片asic优势分析 212

图表：人工智能芯片gpu竞争格局(单位：%) 214

图表：人工智能芯片gpu竞争格局(单位：%) 215

图表：融资额度较高的人工智能芯片项目 217

图表：移动支付产业链构成 224

图表：国内外领先的射频供应商 233

图表：2021-2026小家电主控制芯片需求规模(单位：亿元) 237

图表：2021-2026年国内家电领域芯片市场占比 239

图表：中国键盘市场品牌关注比例分布(单位：%) 242

图表：2021-2026年计算机芯片行业需求规模(单位：亿元) 244

图表：工业控制行业对芯片行业的需求规模(单位：亿元) 248

图表：汽车电子行业对芯片行业的需求规模(单位：亿元) 250

图表：2021-2026年深圳ic产业结构(单位：%) 302

图表：厦门ic产业主要企业 311

图表：华大半导体企业全球布局情况 350

图表：深圳市汇顶科技有限公司经营情况 354

图表：士兰微电子股份有限公司经营情况 356

图表：兆易创新科技集团股份有限公司经营情况 364

图表：无锡华润微电子有限公司的经营情况 385

图表：华润微电子产业情况 386

图表：企业组织架构 397

图表：晟碟半导体(上海)有限公司专利信息 418

图表：江苏长电科技有限公司经营情况(亿元) 421

图表：通富微电子股份有限公司 426

图表：jasper无线网流程 430

图表：aep架构图 431

图表：aep架构图 432

图表：中国各地区物联网产业优势行业 433

图表：物联网框架分析 434

图表：远程抄表典型应用场景示例图 436

图表：智慧家庭连接方式对比 437

图表：高通公司典型蓝牙芯片技术指标对比 439

图表：博通公司典型wifi芯片技术指标对比 439

图表：中国wifi芯片厂商主要产品汇总 440

图表：nfc设备数据操作方式 441

图表：nfc技术协议发展路径 442

图表：2026-2031中芯片市场规模预测 445

图表：知名企业核心技术分布(单位：万件) 450

图表：全球半导体领域专利申请领先企业(单位：万件) 451

图表：我国半导体领域专利申请人申请情况(单位：件) 452

图表：国家大基金一期公开投资企业基本情况 456

图表：大基金一期投资领域分布 460

图表：大基金一期投资领域及部分企业 460

图表：中国部分省集成电路投资基金规模情况(单位：) 464

图表：微笑曲线图 478

把握投资 决策经营！

咨询订购 请拨打 400-886-7071 (免长途费)　Emai：kf@51baogao.cn

报告编号：313716

本文地址：https://www.51baogao.cn/baogao/20230204/313716.shtml

在线订购：点击这里